

2022-2028年中国晶圆代工 行业发展趋势与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国晶圆代工行业发展趋势与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202110/245111.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

国家政策和基金的支持下，我国集成电路市场规模增长迅速。2018年中国集成电路产业销售额6531.4亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2519.3亿元；制造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1818.2亿元；封装测试业销售额2193.9亿元，同比增长16.1%。2011-2018年我国集成电路制造行业销售收入走势图数据来源：公开资料整理

中企顾问网发布的《2022-2028年中国晶圆代工行业发展趋势与投资战略咨询报告》共四章。首先介绍了晶圆代工行业市场发展环境、晶圆代工整体运行态势等，接着分析了晶圆代工行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆代工市场竞争格局。随后，报告对晶圆代工做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆代工行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆代工产业有个系统的了解或者想投资晶圆代工行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章晶圆制造简介

第一节晶圆制造流程

第二节晶圆制造成本分析

第二章半导体市场

第一节2019-2023年半导体产业预测

第二节2019年半导体市场下游预测

第三节全球晶圆代工产业现状

第四节全球半导体制造产业

一、全球半导体产业概况

2019年全球半导体营收超过4100亿美元，其中中国地区销售额占比为35%，是占比最高的国家和地区。根据海关数据，2019年中国集成电路进口额为3050亿美元。2019年中国地区半导体销售额占全球35%数据来源：公开资料整理

二、全球晶圆代工行业概况

第五节中国半导体产业与市场

一、中国半导体市场

二、中国半导体产业

三、中国ic设计产业

四、中国半导体产业发展趋势

第三章晶圆代工产业简介

第一节晶圆制造工艺简介

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介

第三节中国半导体产业政策环境

第四节中国晶圆制造业现状及预测

第四章晶圆厂研究（）

一、中芯国际

（一）企业偿债能力分析

（二）企业运营能力分析

（三）企业盈利能力分析

二、上海华虹nec电子有限公司

（一）企业偿债能力分析

（二）企业运营能力分析

（三）企业盈利能力分析

三、上海宏力半导体制造有限公司

（一）企业偿债能力分析

（二）企业运营能力分析

（三）企业盈利能力分析

四、华润微电子

（一）企业偿债能力分析

（二）企业运营能力分析

（三）企业盈利能力分析

五、上海先进半导体

（一）企业偿债能力分析

（二）企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

六、和舰科技(苏州)有限公司

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

七、bcd(新进半导体)制造有限公司

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

八、方正微电子有限公司

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

十、南通绿山集成电路有限公司()

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

部分图表目录：

图表1晶圆制造工艺流程

图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析

图表32019年度全球营收前13的晶圆代工企业

图表42022-2028年大陆ic内需市场规模变化与预测

图表5主要代工企业产能分布及收益情况

图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用

图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元

图表8半导体产品种类繁多

图表9全球半导体分产品市场占比

图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元

图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化

图表12北美半导体设备制造商bb值

图表13半导体产业链

图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商

图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低

图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒

图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位

图表18国内十大半导体封装测试企业

图表192019年全球晶圆代工排名

图表202015-2019年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势

图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较

图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势

图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析

图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析

图表25全球半导体设备产业版图的变化

图表26国内政策对集成电路产业大力支持

图表27国内半导体进口金额超2000亿美元

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202110/245111.html>